

ABSTRACT

The present invention provides a moisture-absorbent formed body comprising 1) an amine compound and/or a thermally conductive material, 2) a hygroscopic agent, and 3) a resin component, for removing moisture from within the sealed atmosphere of an organic electroluminescent device, and thereby suppressing the occurrence of dark spots.

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年1 月15 日 (15.01.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/006628 A1

(51) 国際特許分類⁷: H05B 33/04

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/008574

(22) 国際出願日: 2003 年7 月7 日 (07.07.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-198922 2002 年7 月8 日 (08.07.2002) JP
特願2002-214029 2002 年7 月23 日 (23.07.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ダイニツク株式会社 (DYNIC CORPORATION) [JP/JP]; 〒615-0812 京都府 京都市 右京区西京極大門町 2 6 番地 Kyoto (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 内堀 輝男 (UCHI-BORI, Teruo) [JP/JP]; 〒522-0341 滋賀県 犬上郡 多賀町大字多賀 2 7 0 番地 ダイニツク株式会社滋賀工場内 Shiga (JP). 大山 兼人 (OHYAMA, Kaneto) [JP/JP]; 〒522-0341 滋賀県 犬上郡 多賀町大字多賀 2 7 0 番地 ダイニツク株式会社滋賀工場内 Shiga (JP). 宮澤 健太郎 (MIYAZAWA, Kentaro) [JP/JP]; 〒522-0341 滋賀県 犬上郡 多賀町大字多賀 2 7 0 番地 ダイニツク株式会社滋賀工場内 Shiga (JP). 川口 洋平 (KAWAGUCHI, Yohei) [JP/JP]; 〒522-0341 滋賀県 犬上

郡 多賀町大字多賀 2 7 0 番地 ダイニツク株式会社滋賀工場内 Shiga (JP). 牧 英彦 (MAKI, Hidehiko) [JP/JP]; 〒522-0341 滋賀県 犬上郡 多賀町大字多賀 2 7 0 番地 ダイニツク株式会社滋賀工場内 Shiga (JP). 中島 祐介 (NAKAJIMA, Yusuke) [JP/JP]; 〒522-0341 滋賀県 犬上郡 多賀町大字多賀 2 7 0 番地 ダイニツク株式会社滋賀工場内 Shiga (JP).

(74) 代理人: 三枝 英二, 外 (SAEGUSA, Eiji et al.); 〒541-0045 大阪府 大阪市 中央区道修町 1-7-1 北浜 T N K ビル Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

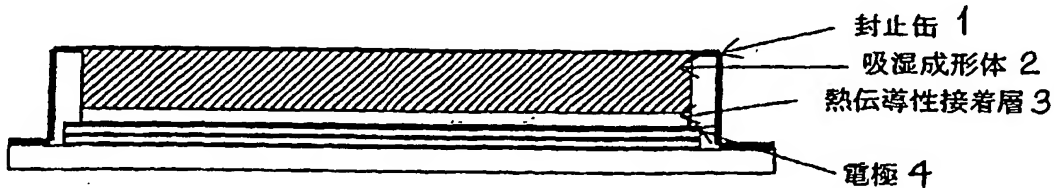
(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: HYGROSCOPIC MOLDING

(54) 発明の名称: 吸湿性成形体



- 1...SHIELD CAN
- 2...HYGROSCOPIC MOLDING
- 3...HEAT TRANSFER ADHESIVE LAYER
- 4...ELECTRODE

(57) Abstract: A hygroscopic molding for removing moisture from a sealed atmosphere of organic EL element and thus for inhibiting the occurrence of dark spots, comprising at least one of an amine compound and a heat transfer material (1), a hygroscopic agent (2) and a resin component (3).

(57) 要約: 有機EL素子の密閉雰囲気内の水分を除去し、ひいてはダークスポットの発生を抑制するため、1) アミン系化合物及び熱伝導性材料の少なくとも1種、2) 吸湿剤及び3) 樹脂成分を含有する吸湿性成形体を提供する。

WO 2004/006628 A1

Rec'd PCT 08 JAN 1995

2004/006628 A1



2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。